

鼎华 BGA 返修台 DH-5860 参数资料



一、功能特点

1. 触屏操作，程序预先内置，无须专业技术培训即可熟练使用，使芯片返修变得非常简单；
2. 微风调节功能，根据芯片大小调节不同风速，返修更高效，焊接小芯片也不会吹跑偏；
3. 进口发热芯，经久耐用，控温精准，绝无虚焊假焊；
4. 超大发热面积，适应各种大小不同尺寸的 PCB 维修；
5. 配备万能支架，轻松放置任何外形的 PCB；
6. 配置外接测温接口，随时对 PCB 或芯片表面进行温度检测，加热温度更精准；
7. 配置真空吸笔，拆卸拿取芯片更方便；
8. 外接 USB 接口，各种返修数据可导入电脑分析储存。

二、技术参数

总功率	Total Power	5200W
上部加热功率	Top heater	1200W
下部加热功率	Bottom heater	第二温区 1200W，第三温区 2700W（加大型发热面积以适应各类 P 板）
电源	power	AC220V±10% 50Hz
外形尺寸	Dimensions	L500×W600×H700 mm
定位方式	Positioning	V 字型卡槽,PCB 支架可 X 方向调整并外配万能夹具
温度控制方式	Temperature control	K 型热电偶（K Sensor） 闭环控制（Closed loop）
温度控制精度	Temp accuracy	±2 度
PCB 尺寸	PCB size	Max 500×400 mm Min 20×20mm
适用芯片	BGA chip	2X2-80X80mm
适用最小芯片间距	Minimum chip spacing	0.15mm
外置测温端口	External Temperature Sensor	1 个，可扩展（optional）
机器重量	Net weight	48kg

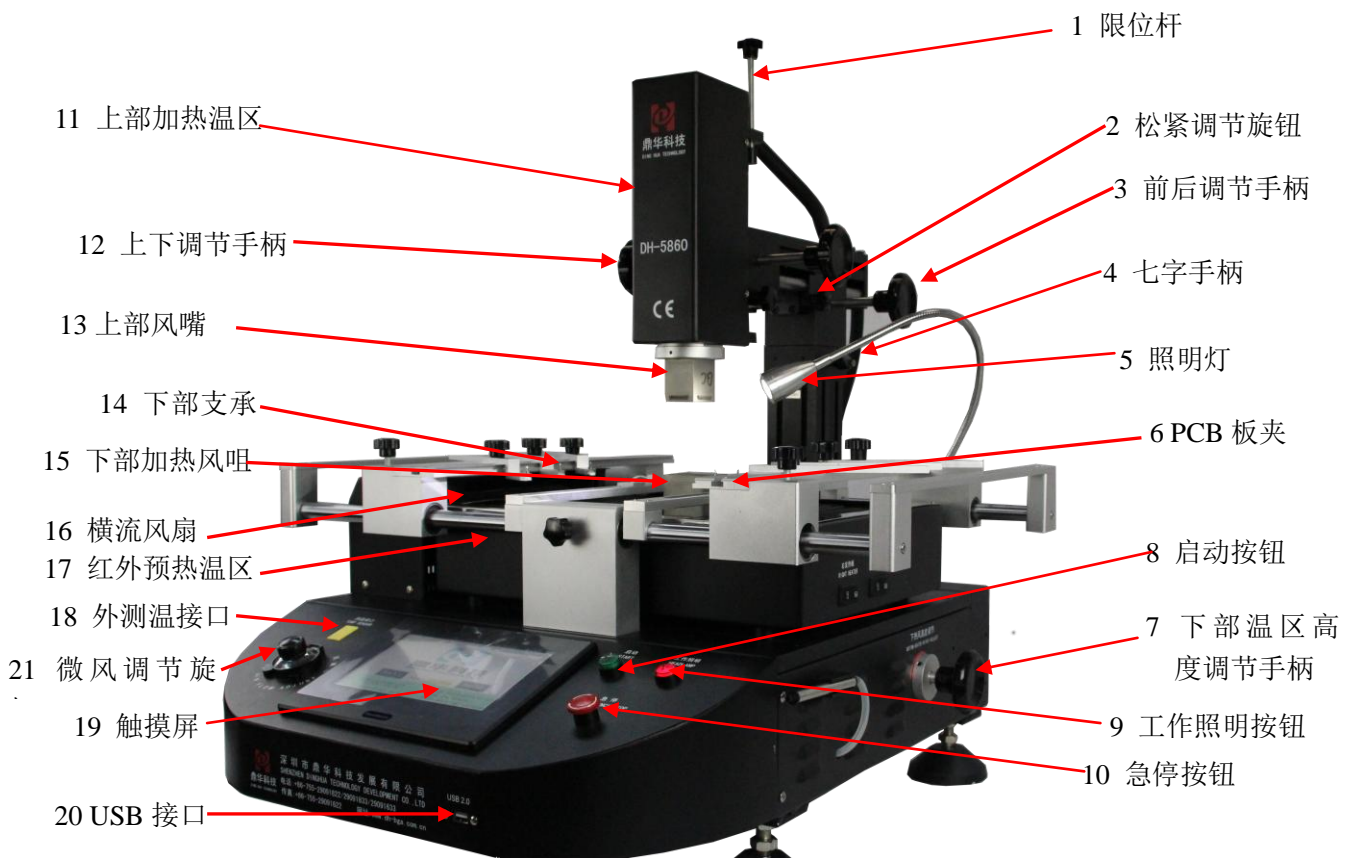
三、功能描述：

1. 嵌入式工控电脑，高清触摸屏人机界面，CPU 中央处理器控制，并具有瞬间曲线分析功能。实时显示设定和实测温度曲线，并可对曲线进行分析纠正；
2. 高精度 K 型热电偶闭环控制和温度自动补偿系统，并结合 CPU 中央处理器和温度模块实现对温度的精准控制，保持温度偏差在±2 度。同时外置测温接口实现对温度的精密检测，并实现对实测温度曲线的精确分析和校对；
3. PCB 板定位采用 V 字型槽，定位快捷、方便、准确，满足不同 PCB 板排版方式及不同大小 PCB 板的定位；
4. 配有微风调节功能，对任何大小的芯片都适用；
5. 灵活方便的可移动式万能夹具对 PCB 板起到保护作用，防止 PCB 边缘器件损伤及 PCB 变形，并能适应

各种 BGA 封装尺寸的返修；

6. 配备多种规格合金风嘴，该风嘴可 360 度任意旋转定位，易于安装和更换；
7. 上下共三个温区独立加热，三个温区可同时进行多组多段温度控制，保证不同温区同步达到最佳焊接效果。加热温度、时间、斜率、冷却、真空均可在人机界面上完成设置；
8. 上下温区均可设置 8 段温度控制，可海量存储温度曲线，随时可根据不同 BGA 进行调用，在触摸屏上也可进行曲线分析、设定和修正；三个加热区采用独立的 PID 算法控制加热过程，升温更均匀，温度更准确；
9. 采用大功率横流风机迅速对 PCB 板进行冷却，以防 PCB 板的变形；同时内置真空泵，外置真空吸笔，以方便快捷取拿 BGA 芯片；
10. 配置声控“提前报警”功能。在拆卸、焊接完成前 5-10 秒以声控方式警示作业人员作相关准备。上下热风停止加热后，冷却系统启动，待温度降至常温后自动停止冷却。保证机器不会在热升温后老化；
11. 具有 USB 接口，可方便下载当前曲线图到 U 盘中存起，以及可以插上鼠标使用加长触控屏使用时间；
12. 经过 CE 认证，设有急停开关和突发事故自动断电保护装置。

四、外形结构：



五、功能介绍

序号	名称	用途	使用方法
1	限位杆	限制上部加热最低位置	旋转到合适位置
2	松紧调节旋钮	锁紧上部温区的前后位置	旋转旋钮
3	前后调节手柄	调节上部温区的前后位置	旋转手柄
4	七字手柄	锁紧上部温区转动角度	旋转手柄
5	照明灯	设备工作时照明	按下按钮
6	PCB 板夹	移动合适位置，夹紧 PCB 板	
7	下部温区高度调节手柄	调节下部风嘴离 PCB 板的距离	旋转手柄
8	启动按钮	启动机器运行	按下按钮
9	照明灯按钮	照明灯开关	按下按钮
10	急停按钮	紧急停机	按下按钮
11	上部加热温区	产生上部热风	
12	上下调节手柄	调节上部温区的上下位置	旋转手柄
13	上部加热风嘴	使热风更集中均匀	使出风口距 BGA 合适位置
14	下部支撑架	防止 PCB 板往下塌陷	移动合适位置顶住
15	下部加热风嘴	使热风更集中均匀	使出风口距 BGA 合适位置
16	横流风扇	PCB 焊接后对 PCB 板冷却	
17	红外发热区	拆焊 BGA 时预热用	
18	测温接口	连接外部电偶，测量实际温度	直接连接测温线
19	触控屏	操作平台储存系统资料	
20	USB 接口	外接 U 盘	插入 U 盘
21	微风调节旋钮	调节风力大小	左右旋转旋钮



六、鼎华优势：

深圳市鼎华科创自动化有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业！我们有实力为您提供优质的产品、完善的服务和先进的技术支持。

因为深圳特殊的产业结构，任何科技类的产品都可以很快复制，所以任何一个行业都鱼龙混杂，有的公司潜心研发产品，也有的公司通过抄袭和模仿，在行业红火的时候快速捞一笔，等行业规范和成熟后再转到另一行业。很多小工厂就几个人，直接买配件组装，没有任何软硬件的研发能力，只做成熟的几个机型，任何软硬件出了问题都得请别人处理，质量没保证，售后服务也非常不及时，这样对客户非常不负责任。相比之下，我们鼎华公司生产的设备有如下优点：

1. 专业：

从 2010 年起，我们有只专注于 BGA 返修台的研发及生产，经过多年集中开发，公司拥有 38 项专利、97 项质控工艺，产品经常升级更新，始终保持和行业的发展一致。

2. 质量：

产品质量和用户口碑是我们赖以生存的基础，所以我们对产品的质量十分注重，所有电子件都采用知名品牌，比如明纬电源、欧姆龙继电器、进口发热芯等等，再加上生产过程中对质量的严格管控，我们实行制造过程中全程编号生产，每位制造部员工都有一个自己的编号，任何制程问题都能很快的追查到对应的制造者，我们对员工实行谁制造的问题谁负责，谁的质量稳定就奖励谁的原则，对每一位员工都灌输一种品质为先的理念，以此确保产品质量的稳定性及优异性。

3. 售后：

我们有自己专业的软件和硬件工程师团队以及负责售后服务的团队，软件或硬件的任何问题我们都能很快分析和及时处理，并且软件终身免费升级，售后服务及时而有保障。

4. 生产环境：

因为我们公司是由新加坡商人投资兴建的，所以公司严格实行 6S 制度，严抓员工素质管理，所有员工进厂第一件事就是培训专业技能和 6S 要求，我们相信，连生产环境都管控不好，怎么可能管控好产品质量。

5. 员工结构：

我们公司是国家级高新企业，工程师和技术员占公司总人数的 30%，业务团队占 15%。其中大专以上学历占到公司总人数的 50%以上，公司员工总体素质偏高。

6. 专利：

我们拥有各种专利共 37 项，并于 2015 年获得高新企业称号，多次获得深圳市及自动化行业颁发的优秀企业荣誉证书。

七、我们的客户：

华为、联想集团、格力电器、比亚迪、腾讯、上海万特、金立手机、小米、厦门航空、成都地铁、长龙铁路、富士康、海康威视、创维、大疆创新、安联锐视、汇金科技、四川长虹、昂扩电子（OnCore）、锐德世科技（RadiSys）、三星、北京航天二院、沈阳军区 93115 部队、北京核地科技、中国科学院沈阳自动化研究所、上海华东科技大学、西安电子科技大学、山东理工大学、青岛科技大学、西南科技大学、六安职业技术学院、南京航空航天大学、广宁中等职业技术学院、重庆邮电大学、四川内江师范学院、长沙中南大学、倍利得、泰辉、路畅科技、珠海优特、珠海欧比特、珠海汇金、伟易达集团、广汽、二汽、长城汽车、中兴、航天科技 513 所、航天火箭技术研究院 289 厂、奋达科技、百富电子、松日数码、中诺科技、艾立丰科技、正威集团、耀晋科技、瑞云电子、易方数码、优特普科技、九州电器、豪恩科技、晶华电子、友讯电子、精成科技、E 路通、中科海信、高斯贝尔、中国科学院研究生院、TCL、美赛达科技、中茂电子、亚哲电子、大众电脑、普联科技、重庆航天火箭电子技术有限公司、重庆缆芯科技有限公司、四川兴弘电子科技有限公司等等，同时公司的产品出口到欧美、东南亚、中东和非洲等 180 多个国家和地区。

八、联系方式：

深圳市鼎华科创自动化有限公司

地址：深圳市宝安区沙井街道新玉路圣佐治科技工业园 6B 栋 4 楼

联系人：刘先生

联系电话：135 3097 8969

Q Q：285 069 7878

邮箱：sales51@dinghua-bga.com



